



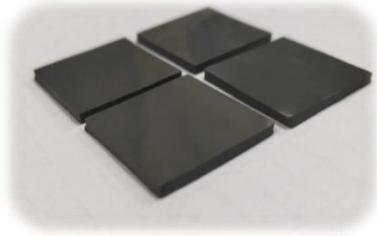
鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

H200MAS 常规系列

【高频导热吸波】规格书



-产品图-

应用特点：

- 吸波与导热双重优势
- 热阻抗较小
- 表面兼容性好自带粘性
- 防火性能高
- 低压力下应用
- 很好的电绝缘性能

应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备
- 5G 基站

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度： $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：2 年

不符合储存条件下：6 个月

产品性能

NO.	参数	单位	测试方法
颜色	灰黑色	---	目视
厚度	0.5~3	mm	ASTM D 374
硬度	30~55(± 5)	Shore C	ASTM D 2240
密度	3.2(± 0.5)	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	≥ 0.1	Mpa	ASTM D 412
延伸率	≥ 150	%	ASTM D 412
撕裂强度	≥ 0.6	N/mm	ASTM D 624
出油率	< 1	%	---
使用频段	> 20	GHz	GJB 2038A-2011
阻燃等级	V-0	---	UL-94
使用温度	-40~160	$^{\circ}\text{C}$	IEC 60068-2-14

热学特性

导热系数	2.0(± 0.2)	W/m·K	ASTM D 5470
热阻	≤ 1.5 (@20Psi/2mm)	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥ 2	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	$\geq 10^{12}$	$\Omega \cdot \text{cm}$	ASTM D 257
介电常数	≥ 5	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤ 0.1	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

